

【原因、判断要点、发生工序】在搅拌或者涂布 SR 时落入油漆屑所引起的（SR 搅拌工序、涂布工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

The defect is caused by fallen peeled paint debris during solder resist ink mixing or solder resist application (Solder resist ink preparation or solder resist application)



【コメント】  
顕微鏡倍率×

【注釋】  
显微镜倍率 ×

【Comments】  
Magnification: ×

## 2-2-1-11 SR 基板加工屑卷込み／SR 卷入树脂屑／Board debris in solder resist

【特徴】基板の加工樹脂屑がSRに巻込まれている状態の欠陥

【特征】SR 卷入树脂屑の缺陷。

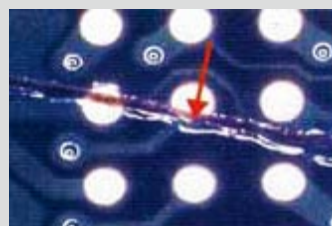
【Characteristics】A laminate debris formed in board machining process is entrapped in solder resist.

【原因・判断ポイント・発生工程】基板の加工樹脂屑がSR塗布直後に付着したり、SRインク中に混入して出来たもの（SR塗布工程）

【原因、判断要点、发生工序】在SR搅拌或者涂布时混入树脂屑所引起的（涂布SR工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

Caused by the attachment of a laminate debris formed in board machining process immediately after solder resist application or solder resist ink mixing (Solder resist application)



【コメント】  
顕微鏡倍率× 150

【注釋】  
显微镜倍率 × 150

【Comments】  
Magnification: ×150



【コメント】  
顕微鏡倍率× 150

【注釋】  
显微镜倍率 × 150

【Comments】  
Magnification: ×150

## 2-2-1-12 SR 下地 DFR 屑残り／SR 基底残留 DFR 屑／Dry film debris on base material under solder resist

【特徴】SR 下地にDFR屑が残されている状態の欠陥

【特征】在SR基底残留DFR屑的缺陷。

【Characteristics】A dry film debris is left under the solder resist



【コメント】  
顕微鏡倍率×

【注釋】  
显微镜倍率 ×

【Comments】  
Magnification: ×

【原因・判断ポイント・発生工程】DFR現像剥離残りや一旦剥離したDFR屑が再転写したものがSRの下にそのまま残って出来たもの（DFR現像剥離工程）